

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-004

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人 股份解质押及质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗叁号”）持有天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 400,000,000 股，占公司股份总数的 11.73%；天朗叁号本次解除质押公司股份 316,160,000 股，占其所持有公司股份数的 79.04%，占公司股份总数的 9.27%。张坤宇先生持有公司股票 50,000,000 股，占公司股份总数的 1.47%；张坤宇先生本次质押公司股份 10,000,000 股，占其所持有公司股份数的 20.00%，占公司股份总数的 0.29%。

● 截至本公告日，张坤宇及其一致行动人天朗叁号、天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗壹号”）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗贰号”）、上海沅乙投资中心（有限合伙）（以下简称“上海沅乙”）累计质押公司股份 246,582,883 股，占其合计所持公司股份总数的 26.61%，占公司总股本的 7.23%。

一、持股 5%以上的股东及其一致行动人的股份解除质押情况

天朗叁号所持有公司的部分股份被解除质押情况：

股东名称	天朗叁号
本次解除质押股份	316,160,000
占其所持股份比例(%)	79.04
占公司总股本比例(%)	9.27
解除质押时间	2024年1月31日
持股数量	400,000,000
持股比例(%)	11.73
剩余被质押股份数量	80,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	20.00
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.35

截至目前，本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。天朗叁号所持有的公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、持股 5%以上的股东及其一致行动人的股份质押情况

公司近日获悉张坤宇先生所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：

（一）本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
张坤宇	否	10,000,000	否	是	2024年1月31日	至解除质押登记日止	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	20.00	0.29	公司全资子公司融资所需

注：数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

三、持股 5%以上的股东及其一致行动人的股份累计质押情况

截至公告披露日，上述持股 5%以上的股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押、质押前累计质押数量	本次解除质押、质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
天朗叁号	400,000,000	11.73	396,160,000	80,000,000	20.00	2.35	0	0	0	0
天朗贰号	300,000,000	8.79	90,000,000	90,000,000	30.00	2.64	0	0	0	0
天朗壹号	150,000,000	4.40	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
上海沅乙	26,582,883	0.78	26,582,883	26,582,883	100.00	0.78	0	0	0	0
张坤宇	50,000,000	1.47	40,000,000	50,000,000	100.00	1.47	0	0	0	0
合计	926,582,883	27.16	552,742,883	246,582,883	26.61	7.23	0	0	0	0

注：数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、后续事项

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年2月2日